भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1666
जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
8 श्रावण, 1947 (शक)

डिज़ाइन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चिप-डिज़ाइन फर्म और स्टार्टअप

1666. श्री बैजयंत पांडाः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसंबर 2021 से अब तक डिज़ाइन-लिंक्ड प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना के अंतर्गत कितने चिप-डिज़ाइन फर्म और स्टार्टअप स्वीकृत हुए हैं और आज की तिथि तक कुल कितनी राशि स्वीकृत और जारी की गई है;
(ख) क्या स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि लक्ष्य परिव्यय को पूरा कर चुकी हैं;
(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार लक्ष्य में कोई संशोधन करने या अतिरिक्त निधि परिव्यय की योजना बना रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) कार्यान्वित उत्पादों या आरंभ की गई प्रतिकृतियों की संख्या कितनी है; और
(ङ) सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रतिधारण और व्यावसायीकरण को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ परिनियोजन में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्पले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 'सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम' को मंजूरी दी है।

इसके भाग के रूप में, सेमीकंडक्टर डिजाइन में घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप और एमएसएमई का समर्थन करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना' को मंजूरी दी गई है।

सेमीकंडक्टर उत्पाद के डिजाइन और व्यावसायीकरण में उच्च प्रवेश बाधाएं, लंबी विकास समय-सीमा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा शामिल है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, डीएलआई योजना निम्नलिखित प्रावधान करती है:

- डिजाइन के शुरुआती प्रोटोटाइप में सहायता के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (ईडीए) उपकरण और बौद्धिक संपदा (आईपी) कोर जैसे डिजाइन अवसंरचना समर्थन।

- डिजाइन प्रोटोटाइपिंग, स्केलिंग-अप और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पात्र लागत का 50% तक का वित्तीय प्रोत्साहन 15 करोड़ रुपए प्रति आवेदन पर कैप किया गया।

- चिप समाधानों के नियोजन और व्यावसायीकरण के लिए पांच वर्षों में निवल बिक्री कारोबार के 6% से 4% का प्रोत्साहन, 30 करोड़ रुपए प्रति आवेदन पर कैप किया गया।

दिसंबर 2021 में शुरू होने के बाद से डीएलआई के तहत निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

- 278 शैक्षणिक संस्थानों (सी2एस) और 72 स्टार्टअप (डीएलआई) को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन (ईडीए) उपकरणों तक अभिगम हेतु अनुमोदित किया गया है।

- 23 फर्मों और स्टार्टअप को विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे निगरानी कैमरा, ऊर्जा मीटर, माइक्रोप्रोसेसर आईपी, नेटवर्किंग एप्लिकेशन, और अधिक के लिए चिप्स डिजाइन करने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।

- इनमें से दस (10) कंपनियों ने वाणिज्यीकरण के लिए अपने डिजाइन प्रोटोटाइपों को बढ़ाने के लिए उद्यम पूंजी (वीसी) निधियन जुटाया है।

- छह (6) कंपनियों ने विभिन्न सेमीकंडक्टर फाउंड्री में प्रोटोटाइप टेप-आउट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

हाल ही में, एससीएल, मोहाली द्वारा 17 शैक्षणिक संस्थानों से 20 चिप डिजाइन सफलतापूर्वक तैयार किए गए हैं।

डीएलआई योजना के अंतर्गत, ईडीए उपकरणों की लागत सहित 803.08 करोड़ रुपए का कुल परियोजना परिव्यय स्वीकृत किया गया है। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर डिजाइन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इस योजना के तहत निधियों को जारी करना चिप्स की स्थापना सहित निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़ा है।

डीएलआई योजना हितधारकों और लाभार्थी कंपनियों के साथ गहन परामर्श के बाद लागू की जाती है। अपेक्षित कोई भी संशोधन उभरती आवश्यकताओं और प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

****